

## 確 約 書

ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社（以下「甲」という。）及び株式会社モルフォ（以下「乙」という。）は、株式会社東京証券取引所（以下「東証」という。）の定める上場規程第422条及び施行規則第2編第4章第2節第2款の規定に基づき、甲が乙より割当を受け取得する2024年9月30日割当予定の乙株式94,500株（以下「本件株式」という。）に関し、以下のとおり確約する。

- 第1条 甲は、本件株式の割当を受ける日である2024年9月30日から2年間において、本件株式の全部又は一部を譲渡した場合には、直ちに、譲渡を受けた者の氏名及び住所、譲渡株式数、譲渡日、譲渡価格、譲渡の理由、譲渡の方法等を、乙に書面により報告する。
- 2 乙は、甲が前項に掲げる期間において本件株式の譲渡を行った場合には、直ちに、甲の氏名及び住所並びに当該譲渡の内容を東証に書面により報告する。
- 3 甲は、乙が前項に基づく報告を東証に行うこと及び東証が当該報告の内容を公衆の縦覧に供することに同意する。

第2条 甲は、前条第1項に規定する期間において、乙から請求を受けた場合には、法令に基づく振替口座簿の写しなど、本件株式の所有状況について確認できる書面を乙に提示する。

第3条 甲は、東証の定める上場規程第422条及び施行規則第2編第4章第2節第2款の規定の内容について承知し、同規定の定めるところにより、東証に対して乙が負う義務を乙が履行するに当たり、乙が甲に必要な協力を求めた場合には、これに誠実に対応することに同意する。

第4条 甲は、乙が本確約の締結後直ちに東証にその写しを提出すること及び東証がこれを公衆の縦覧に供することに同意する。

以 上

2024年9月30日

甲 神奈川県厚木市旭町四丁目14番1号  
ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社  
車載事業部 事業部長 春田 勉  
春田 勉  
Tsutomu Haruta (2024年9月27日 16:20 GMT+9)

乙 東京都千代田区神田錦町二丁目2番1号  
株式会社モルフォ  
代表取締役社長 平賀 督基  
平賀 督基  
平賀 督基 (2024年9月30日 08:46 GMT+9)